

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年9月9日(09.09.2022)



(10) 国際公開番号

WO 2022/185832 A1

(51) 国際特許分類:
C08G 59/20 (2006.01) *C08K 9/06* (2006.01)
C08G 59/50 (2006.01) *C08L 63/00* (2006.01)
C08G 59/66 (2006.01) *C08K 3/36* (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2022/004398

(22) 国際出願日: 2022年2月4日(04.02.2022)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2021-032251 2021年3月2日(02.03.2021) JP

(71) 出願人: 株式会社スリーボンド(**THREEBOND CO., LTD.**) [JP/JP]; 〒1920398 東京都八王子市南大沢四丁目3番地3 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 岩澤 淳也 (**IWASAWA, Jyunya**); 〒1920398 東京都八王子市南大沢四丁目3番地3 株式会社スリーボンド内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 八田 国際特許業務法人(**HATTA & ASSOCIATES**); 〒1020082 東京都千代田区一番町10番地2 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS,

MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))



WO 2022/185832 A1

(54) **Title:** CURABLE RESIN COMPOSITION

(54) 発明の名称: 硬化性樹脂組成物

(57) **Abstract:** The present invention relates to an epoxy resin composition having excellent low-temperature curability and excellent permeability through narrow clearances. This epoxy resin composition contains components (A) through (C). Component (A) is a compound having two or more epoxy groups; component (B) is a silica treated by phenylaminosilane; and component (C) is a compound that cures component (A).

(57) 要約: 低温硬化性に優れ、狭部のクリアランスに対する浸透性に優れたエポキシ樹脂組成物に関する。以下の(A)～(C)成分を含むエポキシ樹脂組成物: (A)成分: エポキシ基を2以上有する化合物; (B)成分: フェニルアミノシランで処理されたシリカ; および (C)成分: (A)成分を硬化させる化合物。